

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、获取补助的基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）、杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）与其他主体共同承担的“硅基 GaN 材料及核心器件的研究”项目中的“硅基 GaN 器件与集成电路工艺融合技术研究”课题（以下简称“该项目”）已通过综合绩效评价，士兰集成、士兰明芯将获得中央财政资金项目后补助款 1494.52 万元，其中：士兰集成的后补助金额为 910.04 万元，士兰明芯的后补助金额为 584.48 万元。

公司于 2020 年 12 月 28 日收到其他主体因该项目转拨付的补助资金 1494.52 万元，其中士兰集成获得的补助金额为 910.04 万元，士兰明芯获得的补助金额为 584.48 万元。

#### 二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补助资金与收益相关，计入当期损益的金额约为 1494.52 万元。最终的会计处理以及对公司 2020 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日